

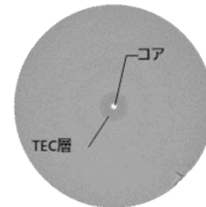


コア拡散ファイバ

- 融着時の熱でモードフィールド径が拡大する、熱拡散コア技術を適用しました。
- シリコンフォトニクスデバイスとの結合に適しています。

TEC SM ファイバ

- 一般的なアクリレート被覆より耐熱性を向上させ、 $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +150\text{ }^{\circ}\text{C}$ の広い温度範囲で使用可能です。



項目	TEC13-15-U25HT-M4
波長帯	1310 nm 及び 1550 nm
モードフィールド径 (μm)	3.4 ± 0.4 @ 1310 nm、 4.0 ± 0.3 @ 1550 nm
コア偏心率 (μm)	≤ 0.5
クラッド外径(長径) (μm)	125 ± 1
伝送損失 (dB/km)	≤ 50 @ 1310 nm、 ≤ 35 @ 1550 nm
カットオフ波長 (nm)	≤ 1280
曲げ損失 (dB, R5 mm \times 10 ターン)	≤ 0.01 @ 1550 nm
許容曲げ半径	2%ブルーフ品: R5 mm
被覆材質	UV 硬化型樹脂
被覆外径 (μm)	245 ± 15
断面イメージ	